

PALTEK

(証券コード:7587)

2017年12月期 決算説明会

2018.2.13 (火)

© 2018 PALTEK Corporation. All rights reserved.



本資料取り扱い上の注意点

本資料に含まれる将来の見通しに関する記述は、現時点における情報に基づき判断したもので、当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める所存であります。

なお、本資料においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当連結会計年度末現在において判断したものであります。

また、実際の業績に影響を与えうるリスクや不確実な要素には、以下のようなものが含まれます。

- ① 国内エレクトロニクス業界の急激な景気変動や需要動向の変化
- ② 仕入先の代理店政策の見直しや再編等により取引関係の継続が困難となった場合
- ③ 不測の事態による当社グループの情報資産が流出した場合
- ④ 為替相場の急激な変動
- ⑤ 新規仕入先商品の立ち上がりの遅れが生じた場合
- ⑥ 顧客の日本国内での製品開発案件が更に海外へシフトし、当社グループの販売活動が及ばない地域へ移管された場合

- ① 2017年12月期 業績結果
- ② 2018年12月期 業績予想
- ③ 今後に向けた取り組み
- ④ 中期経営計画

- ① 2017年12月期 業績結果

(百万円)	2016年12月期		2017年12月期		増減	
	金額	比率	金額	比率	増減額	増減率
売上高	33,544	100.0%	33,075	100.0%	△468	△1.4%
売上総利益	3,586	10.7%	4,275	12.9%	688	19.2%
販管費	3,070	9.2%	3,237	9.8%	166	5.4%
営業利益	515	1.5%	1,037	3.1%	521	101.1%
経常利益	110	0.3%	1,084	3.3%	974	881.1%
親会社株主に帰属する当期純利益	11	0.0%	703	2.1%	691	6,015.2%
1株当たり当期純利益	1.05円	-	64.18円	-	63.13円	6,015.3%

主な増減要因

- 売上高の減少は、半導体事業の減少による
- 売上総利益の増加は、前期には急速な円高に進行により仕入値引ドル建債権の評価額が大幅に減少したが、当期ではドル円相場が安定して推移し、同評価額が若干増加したため
- 販管費の増加は、主に人員の増加による

(百万円)	2016年12月期		2017年12月期		増減	
	金額	比率	金額	比率	増減額	増減率
半導体	31,746	94.6%	31,242	94.5%	△503	△1.6%
デザインサービス	1,649	5.0%	1,633	4.9%	△15	△0.9%
その他	149	0.4%	199	0.6%	50	33.9%
売上高合計	33,544	100.0%	33,075	100.0%	△468	△1.4%

主な増減要因

- 半導体事業は、通信機器向けFPGAや携帯情報端末向けのメモリ製品などが減少
- デザインサービス事業は、航空/宇宙、医療向けが減少
- その他は、病院向けの停電対策システムが増加

■ 売上総利益率の増加は、以下の2つが要因

- ドル円相場により変動する仕入先に対して保有する仕入値引ドル建債権の評価額の増減等により売上総利益が、
2016年では△530百万円（△1.6%分）
2017年では +22百万円（+0.1%分）の影響があったこと

(百万円)	2016年12月期		2017年12月期	
	金額	対売上比率	金額	対売上比率
売上総利益	3,586	10.7%	4,275	12.9%
(うち為替の影響額)	△530	△1.6%	+22	+0.1%
売上総利益 (為替の影響を排除)	4,116	12.3%	4,252	12.9%

- 半導体事業において、売上総利益率が非常に低い民生機器向けの案件の売上高が減少

■ 売上総利益への影響額

- 為替変動の影響額は、為替レートの変動が緩やかだったため縮小

(単位：百万円)	16Q1	16Q2	16Q3	16Q4	17Q1	17Q2	17Q3	17Q4
為替レートの変動（円）	120→ 112	112→ 102	102→ 101	101→ 117	117→ (110)→ 111	111→ (108-114) →112	112→ (114-107) →112	112→ (114-110) →112
為替変動の影響（売上総利益）	-126	-315	-365	277	102	-52	-83	56
仕入値引債権の評価額変動の影響	-437	-657	-795	653	128	-156	-62	109
調達在庫の為替レート変動の影響	310	341	429	-375	-26	104	-21	-53

■ 営業外損益への影響額（期末評価替の影響は含まず）

- 買掛金支払時のレート変動の影響は、為替レートの変動が緩やかだったため、縮小

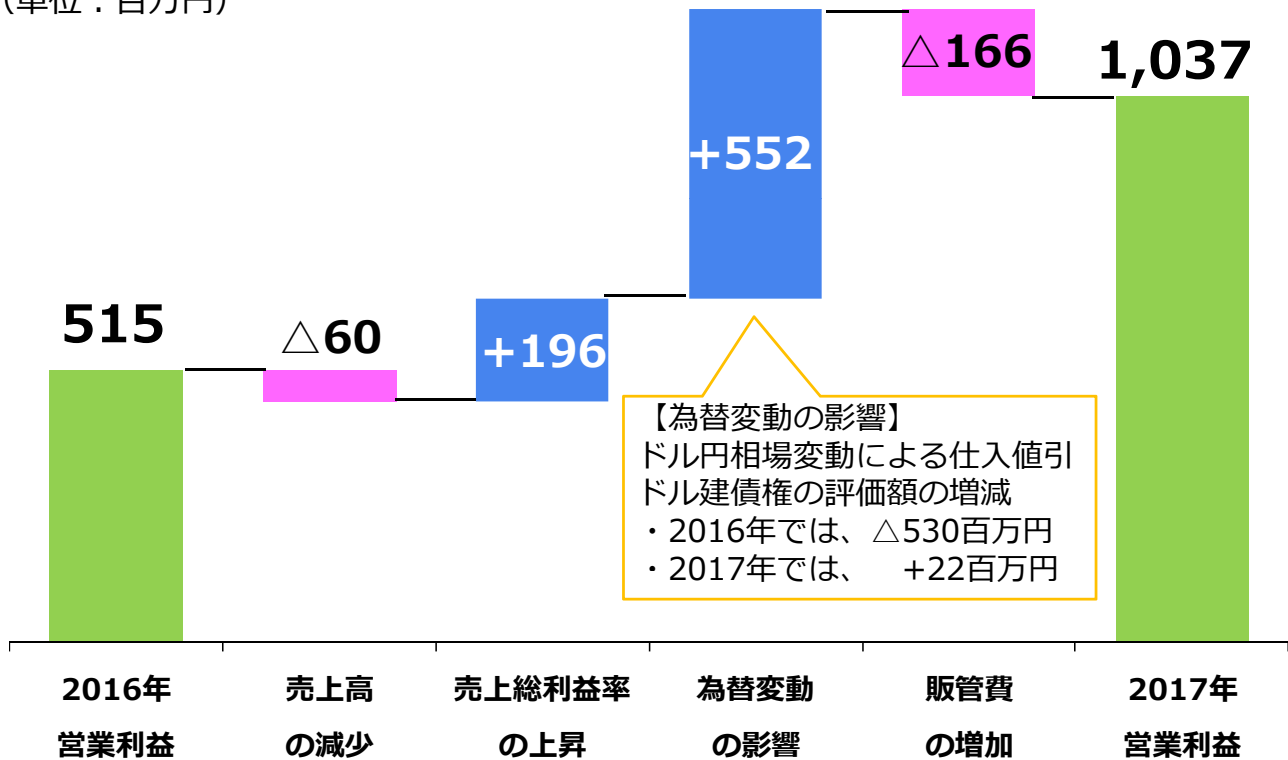
(単位：百万円)	16Q1	16Q2	16Q3	16Q4	17Q1	17Q2	17Q3	17Q4
買掛金支払時のレート変動の影響 (営業外)	407	253	211	-494	36	46	54	-24

- 売掛金受取時のレート変動の影響額は、為替予約のため変動影響が縮小

(単位：百万円)	16Q1	16Q2	16Q3	16Q4	17Q1	17Q2	17Q3	17Q4
売掛金受取時のレート変動の影響 (営業外)	-263	-218	-133	15	25	-29	-34	12

営業利益の増減分析

(単位：百万円)



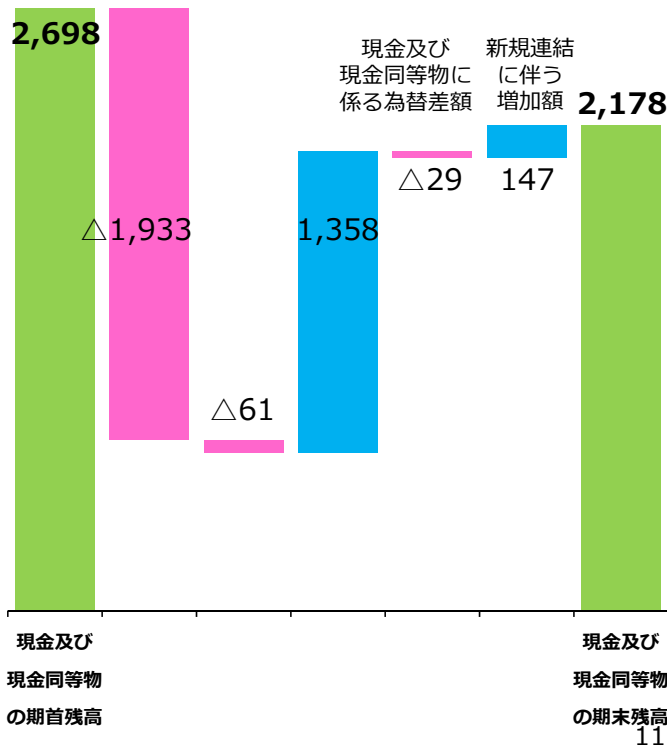
連結貸借対照表の状況

		(百万円)	2016.12	2017.12	増減額	主な増減理由
資産内訳	現金及び預金		2,698	2,178	△519	
	売上債権		7,064	7,087	23	
	商品		3,094	3,559	464	
	その他流動資産		2,180	3,904	1,723	未収入金が大幅に増加
	固定資産		460	450	△10	
資産合計			15,499	17,180	1,680	
負債純資産内訳	仕入債務		1,615	1,387	△227	
	短期借入金		3,500	5,030	1,530	仕入債務の支払いのため
	その他流動負債		1,220	999	△220	
	固定負債		269	261	△7	
	純資産		8,895	9,501	606	
負債・純資産合計			15,499	17,180	1,680	

連結キャッシュ・フローの状況

2017年12月期のキャッシュフローの動き

(百万円) 営業CF 投資CF 財務CF



(百万円)	2016年 12月期	2017年 12月期
現金及び現金同等物の期首残高	1,199	2,698
営業CF	2,307	△1,933
投資CF	△17	△61
財務CF	△823	1,358
現金及び現金同等物の期末残高	2,698	2,178

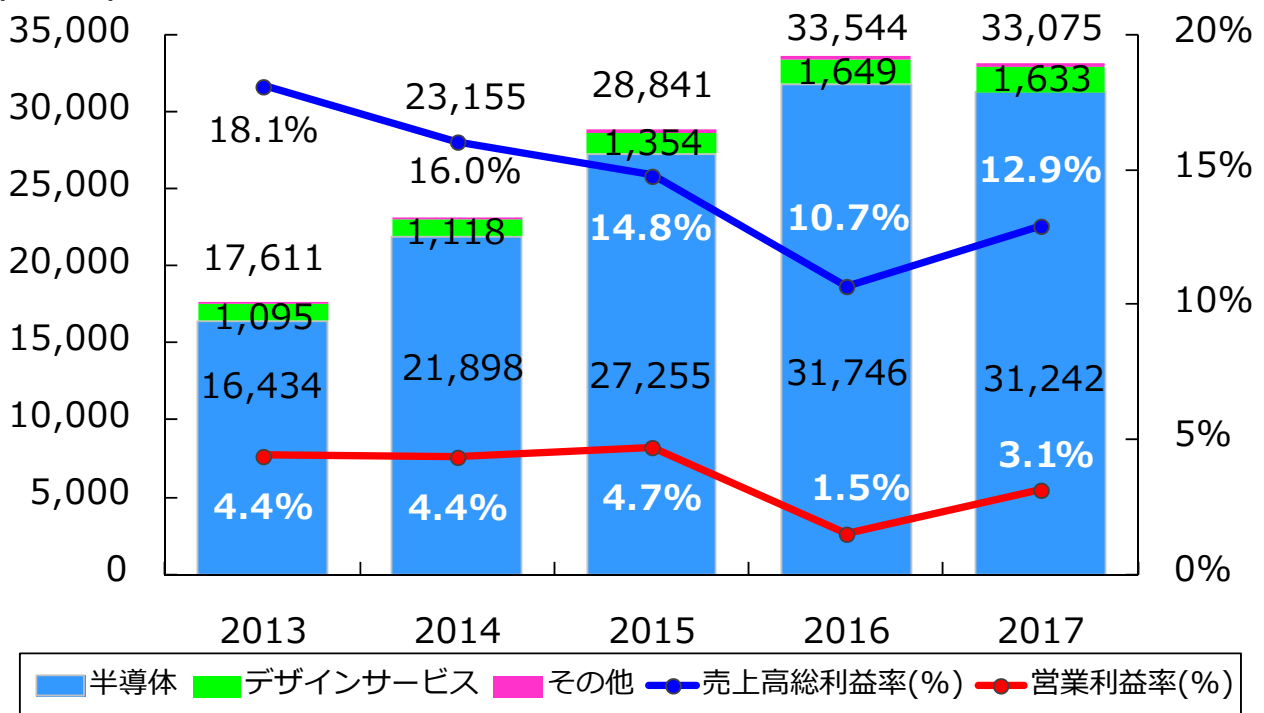
2017年12月期のキャッシュフローの動き

- 【営業CF】 税金等調整前当期純利益の計上した一方で、未収入金の増加、仕入債務の減少等により支出
- 【投資CF】 有形固定資産、無形固定資産等を取得したこと等により支出
- 【財務CF】 配当金支払いを実施した一方で、借入れの実施等により収入

© 2018 PALTEK Corporation. All rights reserved.

連結業績推移

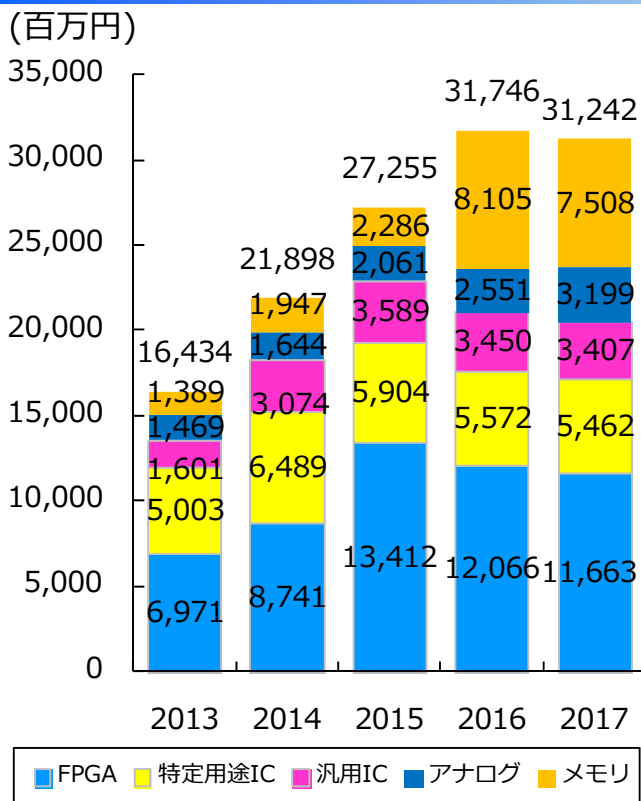
(百万円)



事業別の実績

© 2018 PALTEK Corporation. All rights reserved.

半導体事業の状況（製品別）



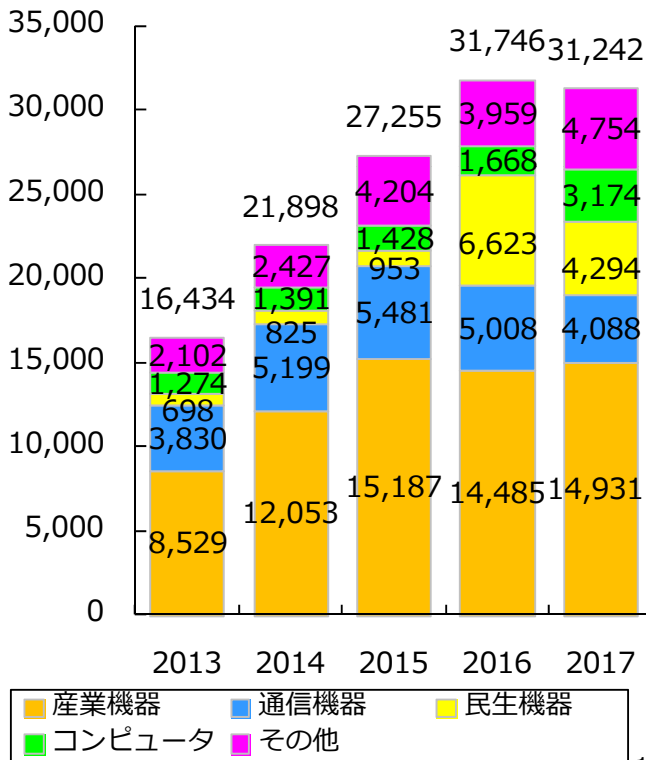
業績の推移

- FPGA
通信機器、計測機器向けが減少
- 特定用途IC
インタフェース関連製品のメーカーとの取引終了のため減少
- 汎用IC
オフィス機器向け等が減少
- アナログ
スーパーコンピュータ向けが増加
- メモリ
スーパーコンピュータ向けが増加するも、海外メーカー向けが大幅に減少



半導体事業の状況（用途別）

(百万円)



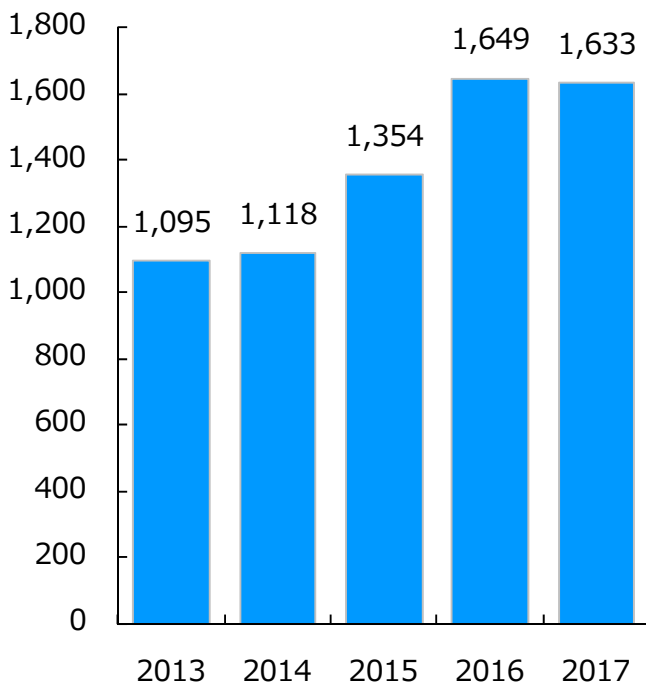
業績の推移

- 産業機器
オフィス機器向けが減少するも、ファクトリーオートメーションなどが増加
- 通信機器
通信インフラ向けが減少
- 民生機器
海外メーカー向けが大幅に減少
- コンピュータ
スーパーコンピュータ向けが増加



デザインサービス事業の状況

(百万円)



業績の推移

- 産業機器、放送機器向けが増加するも、航空/宇宙、医療機器向けが減少

2

2018年12月期 業績予想

事業セグメントの変更について

これまでの事業セグメント



今後の事業セグメント

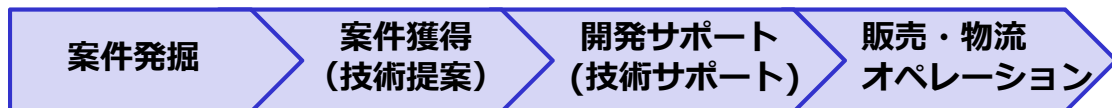


※スマートエネルギー事業は、ソリューション事業に入ります

■ 取引形態の変更内容

- 2018年1月より、主要大手顧客でのFPGA販売において販売・物流オペレーション業務のみを実施
- 取引形態変更により、売上利益率は大幅に低下
- その他の顧客は、変更なくPALTEKがすべて担当

今までの販売活動 : (下記の主要大手顧客以外は変更なし)



2018年1月以降の主要大手顧客への販売活動



: PALTEK担当 : ザイリンクス社担当

■ 外部環境

- 車載機器、データセンター、半導体製造装置向けは堅調に推移
- 半導体の需給は逼迫
- 次世代通信5Gの立ち上がり時期は不透明

■ 主要仕入先ザイリンクス社との取引形態変更の影響

- 取引形態変更の対象となる主要大手顧客との間で合意できた顧客から、販売・オペレーション業務のみの対応を実施
- 取引形態変更による売上総利益の減額は、形態変更の開始時期が遅延した顧客があるため、5億円と想定

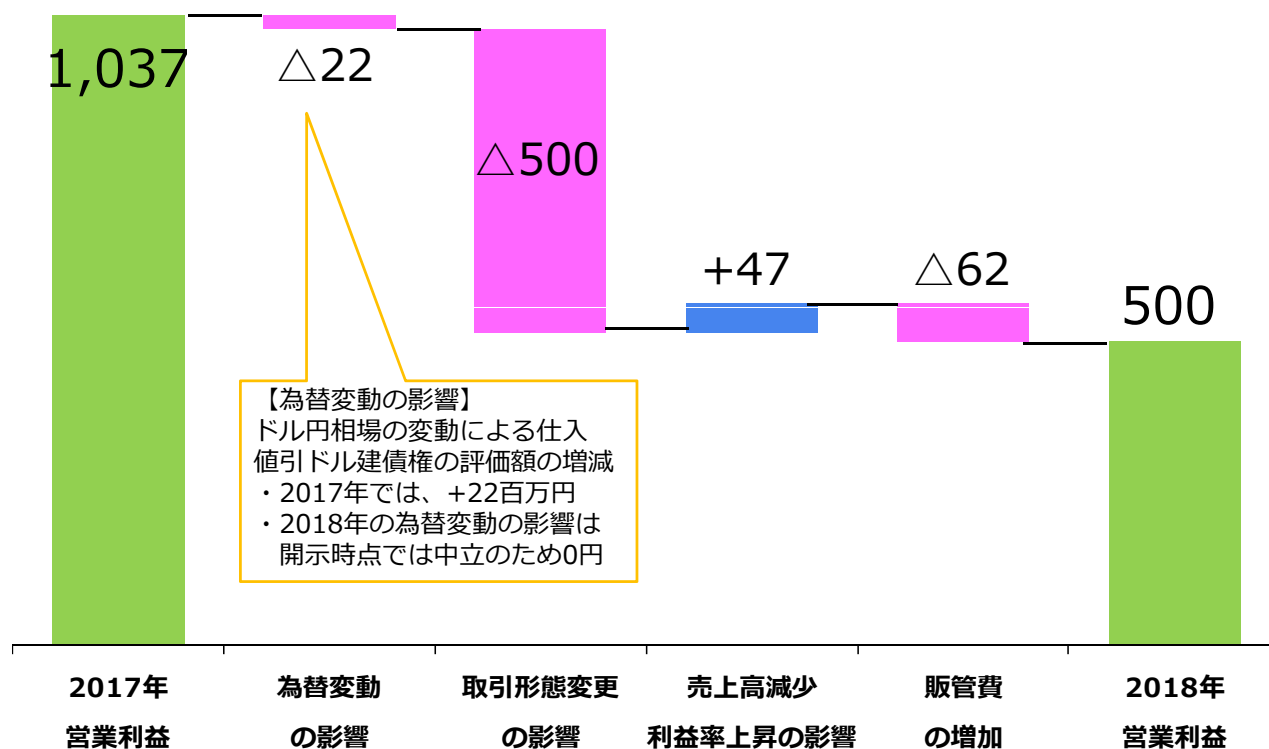
■ 為替の影響

- 開示時点において、ドル円相場は若干円高方向に進んでいるが、値動きが激しくなることが懸念され、為替動向を見通すことが非常に困難

(百万円)	2017年12月期 実績			2018年12月期 予想			通期増減	
	上期	下期	通期	上期	下期	通期	増減額	増減率
売上高	16,074	17,001	33,076	14,000	16,000	30,000	△3,076	△9.3%
売上総利益	2,116	2,158	4,275	1,830	1,970	3,800	△475	△11.1%
売上総利益率	13.2%	12.7%	12.9%	13.1%	12.3%	12.7%	-	-
販管費	1,583	1,654	3,237	1,630	1,670	3,300	62	1.9%
営業利益	533	504	1,037	200	300	500	△537	△51.8%
営業利益率	3.3%	3.0%	3.1%	1.4%	1.9%	1.7%	-	-
経常利益	563	521	1,084	150	250	400	△685	△63.1%
当期純利益	370	332	703	100	170	270	△433	△61.6%

営業利益の減少理由

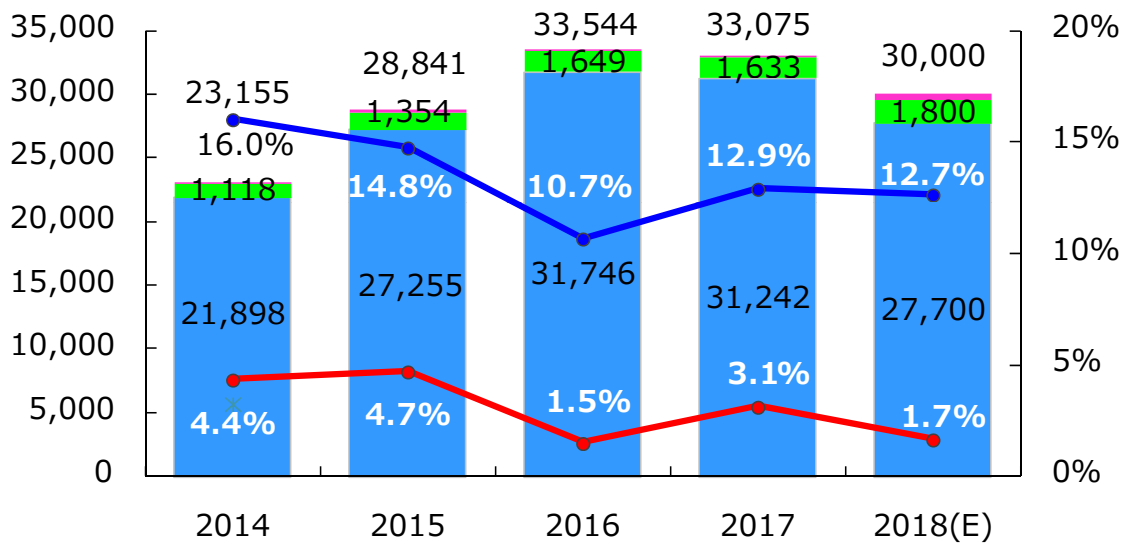
(単位：百万円)





業績見通しの推移

(百万円)



■ 半導体 ■ デザインサービス ■ ソリューション ● 売上高総利益率(%) ● 営業利益率(%)

- 売上高 : 半導体事業が減少
- 売上総利益率 : 半導体事業での利益率改善およびデザインサービス事業、ソリューション事業の売上高が増加するものの、FPGAの利益率が低下するため全体としても低下
- 営業利益率 : 売上高減少に伴い低下



2018年12月期 剰余金配当の方針

株主還元方針および1株当たり配当金

- 利益配分については、経営基盤の強化や将来の事業展開を考慮し、適正に配分。株主の皆様へは、配当金にて還元いたします
- 配当金については、安定的な配当を維持しながら、業績に対する配当性向を勘案
- 2018年12月期配当金は、1株あたり10円を予定

配当金の推移

	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年(予)
1株当たり配当金	5円	8円	8円	15円(※)	13円	13円	10円
配当性向(連結)	-	20.6%	16.2%	24.4%	1,238.7%	20.3%	40.6%
当期純利益(百万円)	△106	443	563	674	11	700	270

※ 普通配：12円、記念配：3円

■ 対象となる株主様

- 毎年12月31日現在の当社株主名簿に記載または記録された100株以上を保有している株主様

■ 株主優待の内容

- 毎年12月31日現在の保有株式数と継続保有期間に応じて、優待品（クオカード）を年1回贈呈

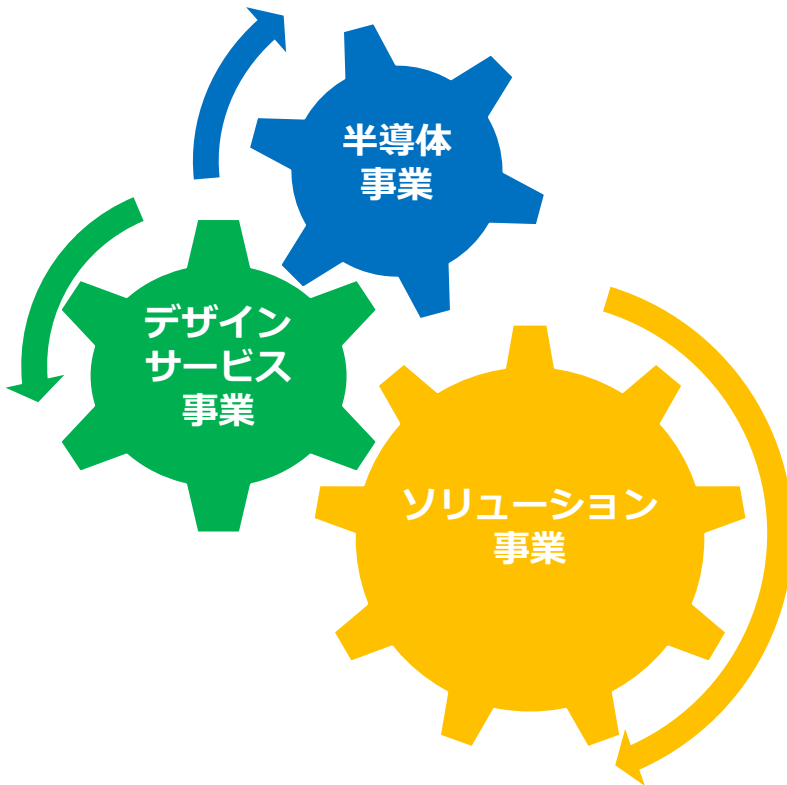


保有株式数	継続保有期間	
	3年未満	3年以上
100株以上～500株未満	クオカード500円分	クオカード1,000円分
500株以上～1,000株未満	クオカード1,000円分	クオカード2,000円分
1,000株以上	クオカード2,000円分	クオカード3,000円分

3

今後に向けた取り組み

既存ビジネスをベースにした ソリューション事業への発展



<半導体事業>
成長市場に向けた
トータルソリューション提案

<デザインサービス事業>
ODMビジネスの拡大
～医療、航空・宇宙、
放送/映像、産業機器、
IoT、インフラ分野～

<ソリューション事業の拡大>
・ビデオソリューション
・IoTソリューション
・物流ソリューション
・エネルギーソリューション
・ソリューションビジネス開拓

FPGAリソースを異動

- FPGAビジネスにおける主要大手顧客向けのリソース（営業・技術）を戦略的に新規事業、既存事業に振り向ける
 - **FPGA：成長が見込まれる顧客に更にリソースを強化**
 - デザインサービス事業（ODMビジネス）の営業力強化
 - FPGAをベースにしたソリューションの開発、販売
 - 成長市場向けの半導体ビジネス強化
 - ソリューション事業の営業力強化



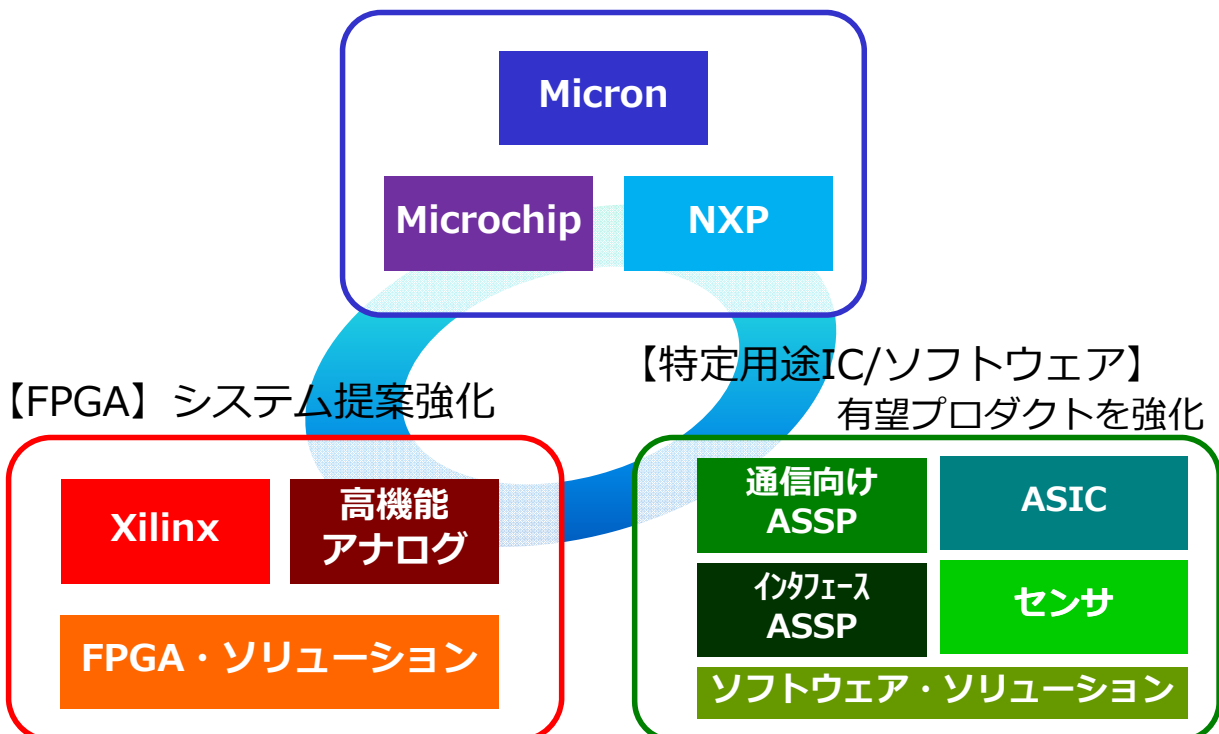
【事業環境】

- **車載分野、IoTが成長市場へ**
 - 自動運転、電気自動車(EV)が更に発展
 - さまざまなモノがインターネット接続に接続され、IoT関連の半導体市場が成長
- **AI、ビッグデータの活用により半導体市場が拡大**
 - 携帯端末やデータセンター向けが成長
 - 携帯端末で動画配信等が進む中でメモリ搭載容量も増加し、メモリ等の市場が成長

取り組み

- IoT,データセンター等の成長分野に提案力を強化 (Xilinx, Micron, NXP, Microchip)
- 特徴ある有望製品を扱うメーカーの開拓 (日本、欧米、アジア)

【汎用IC・メモリ】幅広いマーケットに訴求



- 新製品提案/新規案件獲得の強化
- マルチ提案（複合商材）の強化
XILINX(FPGA)+Micron(メモリ),MPS(電源)
- システム提案力/サポート力の強化
新たな市場開拓（non-FPGAユーザー）
- 成長市場への注力



産業機器、放送機器、サーバー/ストレージ、医療機器、航空・宇宙
→ AI, IoT, 5G, 8K/4K関連



ネットワーク データセンタークラウド 車載 (ADAS) 産業機器 医療機器 エネルギー

- FPGAベースのソリューション開発・販売
 - 顧客ニーズにあったFPGAベースの製品を開発/販売（評価ボード、モジュールなど）
 - データセンター向け、AI等のソリューション構築など

【事例】

FPGAコンピューティングプラットフォーム「DATA BRICK」をデータセンターなどに向けて提案



PALTEK自社製品「DATA BRICK」

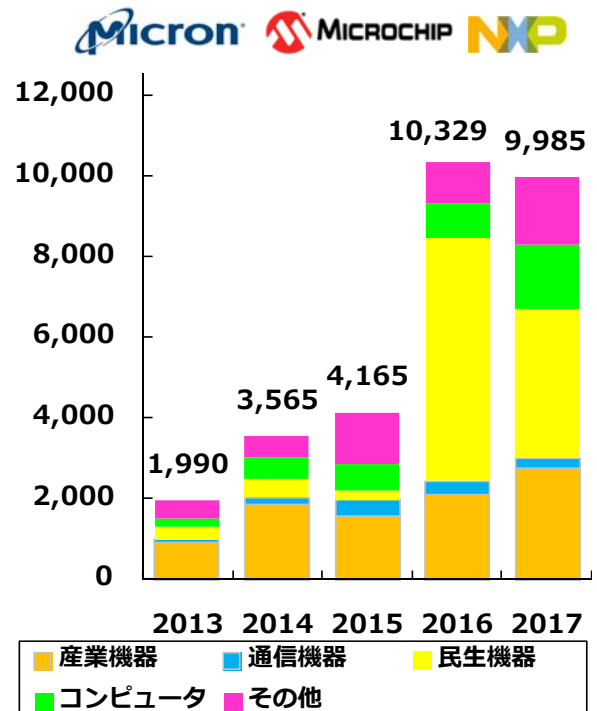
■ 成長マーケットへの注力

- サーバー/ストレージ
- 産業機器 (IoT含)
- 車載機器
- 通信機器
- 医療機器

■ 複数商材の提案力の強化



主要3製品の売上推移

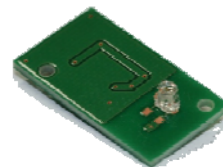


■ コーデンシ社製のセンサモジュール取扱開始

- センサモジュールの活用で、センサ特性およびアナログ技術に関する知見がなくても、センサを組み込んだ機器を容易に開発可能
- ターゲット市場：FA機器、空調機器、照明機器など



サーモパイルセンサモジュール



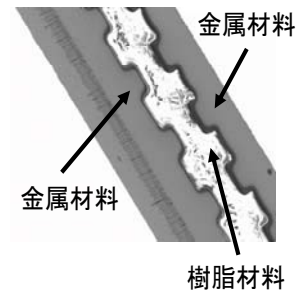
照度センサモジュール

株式会社テクノロジー・イノベーションの技術を活用

コーデンシ様がセンサモジュールを開発するにあたり、グループ会社の株式会社テクノロジー・イノベーションのセンサ信号処理技術を活用

「微細な金属材料と樹脂材料の複合立体形成技術」を開発

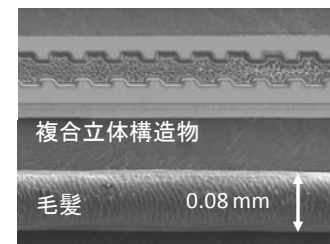
- MEMS技術を応用し、金属材料と樹脂材料からなる微細な立体構造物を一括で形成
- センサや電子デバイスの飛躍的な小型化に貢献可能
- テクノロジー・イノベーション、小野田製作所および長野県工業技術総合センターと共同開発



【応用分野】

導体金属と絶縁体の微細立体構造が応用が想定できる分野

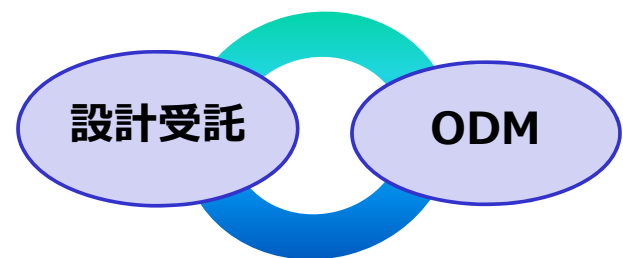
- 半導体検査装置
- 電子部品
- 先進医療装置



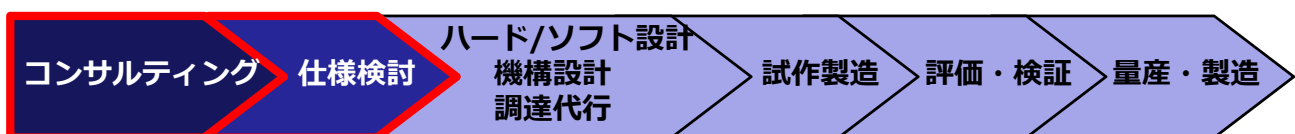
- 製品実現に向けた提案から設計・試作・評価・量産までを設計・製造受託

■ 事業構成

- 設計受託
- ODM
- 開発サポート製品販売



提供するサービス



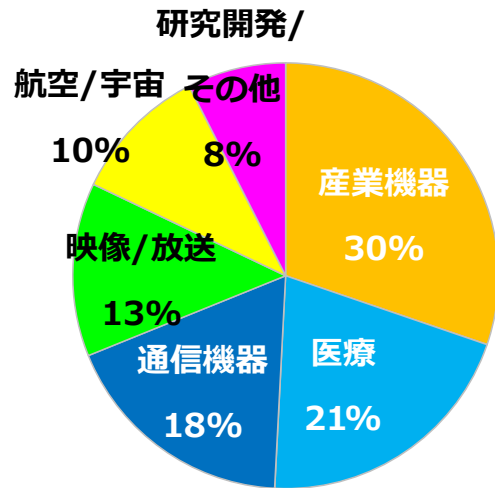
強み

※ ODM (Original Design Manufacturing) : 発注元企業のブランドで販売される製品を設計するだけでなく製造も行うこと

産業機器、医療機器、航空/宇宙、映像/放送分野での設計受託・ODMが堅調

- 医療
 - 次世代医療機器の開発
 - etc
- 産業機器
 - I o T 関連機器
 - 半導体製造装置
 - 監視カメラ装置
 - etc
- 放送機器
 - 4K/8K関連 伝送装置
 - etc

用途別売上構成（2017年）



2020年のオリンピック開催に伴い、8K/4K関連案件の映像システムへ注力

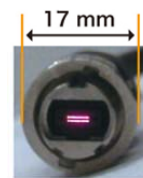
【事例】“U-SDI”（NHK様推奨技術）

8K映像に最適なインタフェース“U-SDI” 技術を活用した案件獲得に注力



U-SDI接続可能な「ImageCUBE2」を活用し、高画質(8K)伝送が必要とされる分野へ展開

- 放送機器関連
- 医療機器関連
- 検査装置 など



光ファイバーケーブル



PALTEK自社製品「ImageCUBE2」

■ PALTEKの展開するソリューション事業

- 半導体事業、デザインサービス事業で培ったシステム提案力、技術サポート力をベースに展開
- 最終製品レベルでのソリューション提案を実施
- 自社製品（ハードウェア、ソフトウェア、システム）の開発・販売

■ ソリューション事例

ビデオソリューション	映像配信システム(4K_H.265/HEVC)
IoTソリューション	車載関連(TPMS)、呼吸見守りシステム
物流ソリューション	紙梱包資材システム
エネルギーソリューション	停電対策システム

■ ビデオソリューションのシステム概要

- 最新技術の映像配信システム (HEVC) を提供
2K/4K_HEVC コーデック(データ圧縮)システム

【ターゲット市場】
映像配信メディア、防衛、セキュリティ、医療分野など

エンコーダ (データ圧縮) → 公衆IP網 → デコーダ (データ伸張)

- Haivision社製品とExplorer製品を組み合わせ提案・販売

Explorer 4K_H.265/HEVC コーデック

Explorer 4K265P
Haivision 738-94 38

Explorer自社製品
「4K_H.265/HEVCコーデック」

■ LDL社製 タイヤ空気圧監視システム(TPMS)の概要



受信機間のワイヤレス通信により、
タイヤの空気圧および温度情報を伝達

タイヤの空気圧および温度情報は、
運転席のディスプレイに表示



● ディスプレイ
(表示機兼受信機)



● レシーバコントロール
ユニット
(RCU、中継器)



● ホイールユニット
センサー
(WUS)

製品概要動画：<https://www.youtube.com/watch?v=Z00Zm2ETQ8c&feature=youtu.be>

■ 新規市場の創造

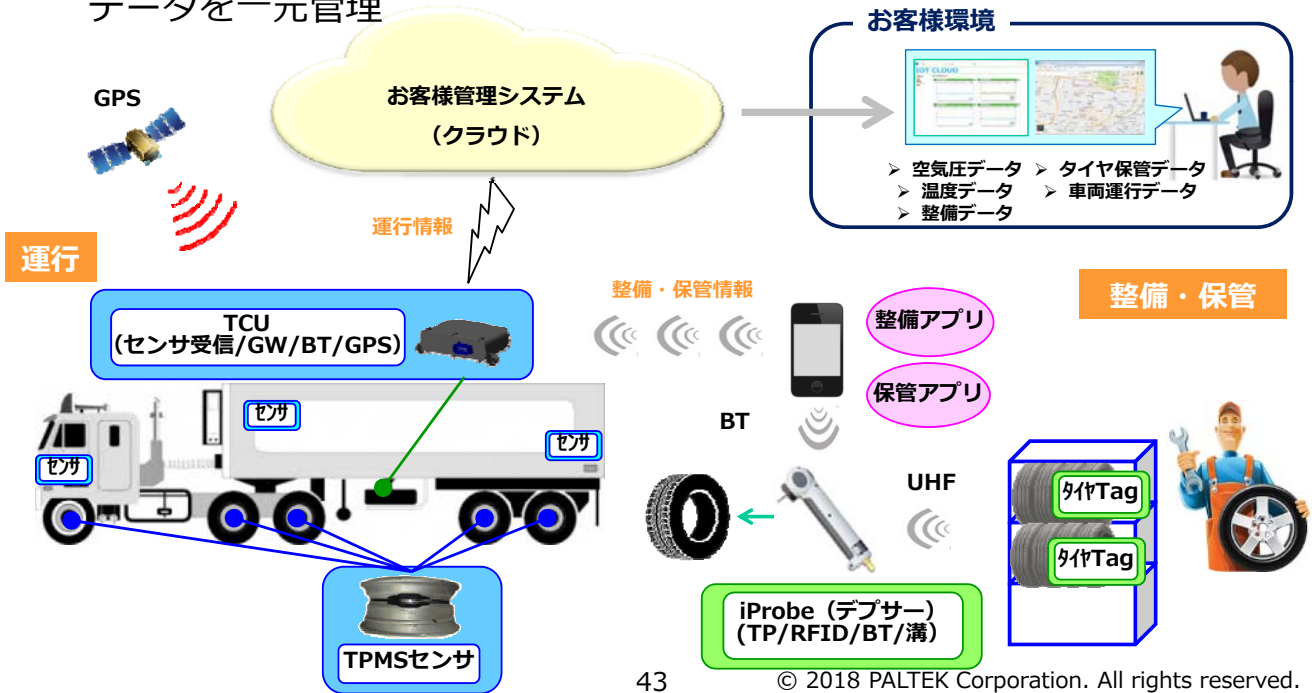
- タイヤ空気圧監視システムは、日本では2020年以降に法制化される可能性あり
- タイヤメーカー、トラックディーラー、大手運送会社、バス会社へタイヤ空気圧監視システムを提案/販売

■ 進捗状況

- プロモーション継続中
 - 物流事業者（運送会社）
 - タイヤメーカー
 - バス事業者

今後の展開：通信型TPMSの活用事例

- 走行中にタイヤ空気圧モニタリングシステムから公衆無線回線を使用し空気圧、温度および車輛の運行情報を取得し、遠隔管理可能
- タイヤTag(RFID)を活用し、タイヤ保管状況などの履歴情報および整備データを一元管理



紙梱包資材ビジネスの販売

- 紙梱包資材による物流コストの削減提案を推進
 - 梱包部材コスト削減、保管スペースの削減
 - 作業スピードの効率化
 - 環境への配慮



- 既存の梱包資材から、紙梱包資材への変更提案
 - 各業界の物流がサードパーティロジスティクス(3PL)に集約
 - 大手サードパーティロジスティクスを中心に提案中
- 進捗状況
 - 日常雑貨の通販会社、3PLで受注済
 - 複数社トライアル中
 - 化粧品メーカー、電子部品専門倉庫業者
 - 3PL/一般物流
 - 計測器メーカー、大型機械制御盤メーカー
- 今後の展開
 - 今後拡大が見込める物流市場において、ビジネス拡大の足がかりを作る
 - 効率的なオペレーションサービスを追求するため、システムのIoT化を図る

- 非接触バイタルセンサーを活用した **LIQUID** 保育向け呼吸見守りシステムの提供

【背景】

- 女性の社会活躍の場が広がる
- 乳幼児を保育施設に預ける必要性が増加
- 乳幼児を預かる保育施設の負担増
 - 乳児睡眠中5分に一度呼吸状況を確認



■ 保育向け呼吸見守りシステム「IBUKI」

- 保育士の代わりに睡眠時赤ちゃんの呼吸を見守るセンサ
- 体に直接接触することなく睡眠中の呼吸数・体動を検知
- 乳幼児突然死症候群(SIDS)防止などに活用
- 2017年9月に東京都など一部の地方公共団体で、助成金の支給が決定
- 100件以上に見積もり提出済み

IBUKI



■ 経営方針

- ・ ソリューションサプライヤーとして社会的意義ある価値を創出し、ニーズとシーズを照らし合わせた、付加価値の高い製品提案、ソリューションの開発
- ・ 収益性の高い経営を目指す

■ 各事業の方向性

ソリューション事業

培ってきた技術力をベースに、最終製品レベルのソリューションを開拓、開発、販売

デザインサービス事業

画像処理・FPGA設計などコア技術の強みを活かし、ODMビジネスを拡大、収益性を向上

半導体事業

成長市場にフォーカスし、安定的に収益を上げていく事業ポートフォリオを構築

今後のビジネスステータス

	2018年	2019年	2020年
成長市場ビジネス(半導体)の強化	営業人員増強 顧客拡大	顧客拡大 案件獲得強化	案件獲得の継続
FPGAベースのソリューション開発・販売	ソリューション 開拓・開発	ソリューション 提案、案件獲得	案件獲得の継続
ODMビジネスの強化	営業人員増強 新規市場開拓	案件獲得	案件獲得の継続
ビデオソリューションの強化	プロモーション 自社製品追加開発	ソリューション提案力 強化、案件獲得	案件獲得の継続
タイヤ空気圧監視システムの販売強化	プロモーション IoTビジネス構築	プロモーション IoTビジネス展開	販売・顧客拡大 IoTビジネス展開
紙梱包資材ビジネスの販売強化	新規顧客開拓 既存顧客への提案	新規顧客開拓 の継続、案件獲得	案件獲得の継続

: 投資期

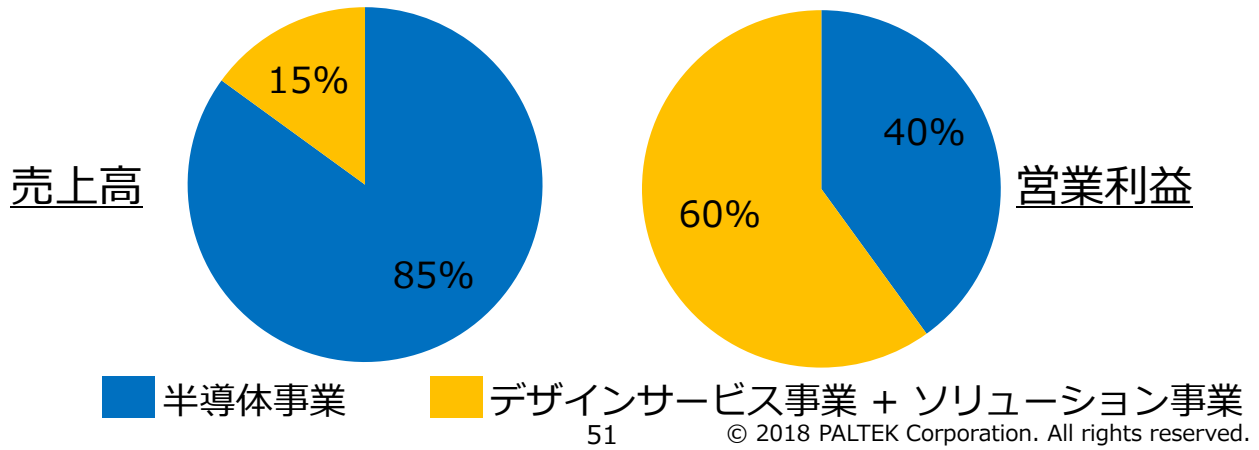
: 黒字転換期

: 利益成長期

■ 数値目標 (2020年)

売上高	400億円以上
営業利益率	5%以上

2020年時の売上高/営業利益の構成イメージ



参 考 資 料

(百万円)	2017年12月期 実績			2018年12月期 業績予想			通期増減	
	上期	下期	通期	上期	下期	通期	増減額	増減率
半導体	15,239	16,003	31,242	12,950	14,750	27,700	△3,542	△11.3%
FPGA	5,952	5,711	11,663	4,500	6,200	10,700	△963	△8.3%
特定用途IC	2,830	2,632	5,462	2,150	2,050	4,200	△1,262	△23.1%
汎用IC	1,616	1,791	3,407	1,600	1,850	3,450	42	1.2%
アナログ	1,618	1,581	3,199	1,050	850	1,900	△1,299	△40.6%
メモリ	3,221	4,287	7,508	3,650	3,800	7,450	△58	△0.8%
デザインサービス	767	866	1,633	850	950	1,800	166	10.2%
ソリューション	68	131	199	200	300	500	300	150.5%
売上高合計	16,074	17,001	33,075	14,000	16,000	30,000	△3,075	△9.3%
営業利益	533	504	1,037	200	300	500	△537	△51.8%

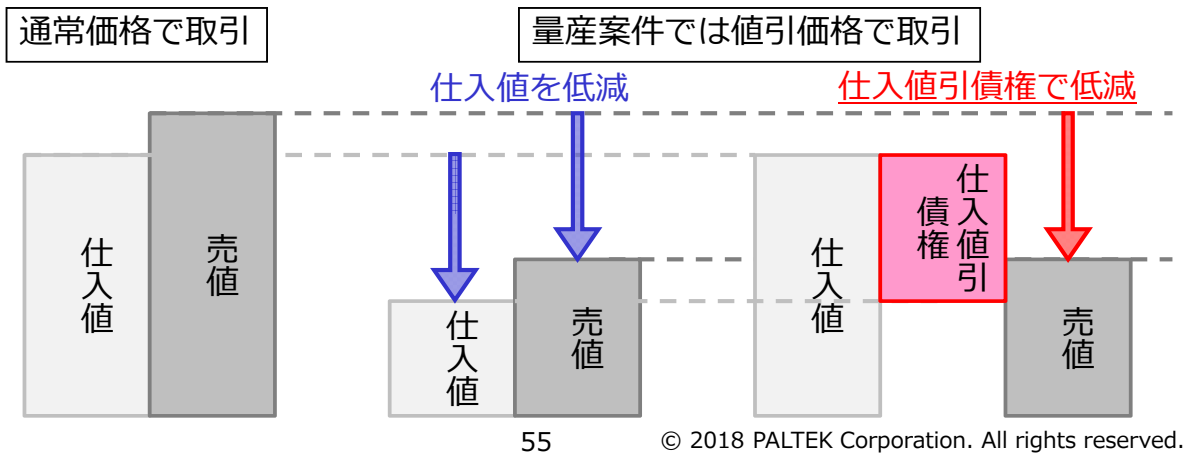
為替変動による影響について

- 為替変動により当社グループの利益は以下の4点で影響を受けます
 - ① 仕入値引ドル建債権の為替変動による影響
 - ② 調達在庫の為替変動による影響
 - ③ 決済時のドル調達レート変動による影響
 - ④ ドル建売掛金入金時のレート変動による影響

為替変動による影響の発生要因①

【仕入値引ドル建債権の為替変動による影響】

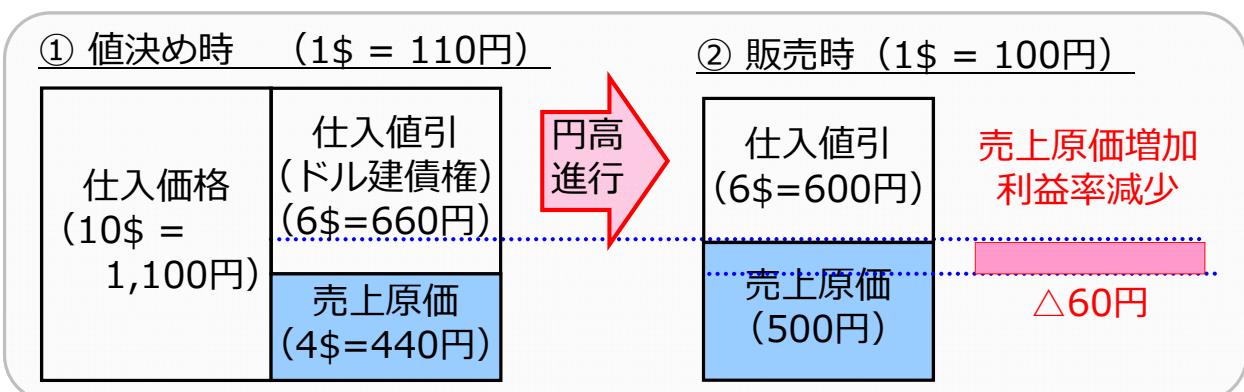
- 当社が仕入先に対して保有する『仕入値引ドル建債権』が、為替レートの変動により評価額が増減することで、業績に大きな影響を与える
- 仕入値引ドル建債権について：
 - 量産案件によっては、通常価格よりも低い価格での販売を要請されることがある
 - その場合、仕入先との間で仕入価格の低減交渉を行う
 - その実現方法は、「仕入値自体の低減」と「仕入値引債権の付与による低減」



急速な円高進行による仕入値引債権の評価額減少

- 仕入値引債権の評価額の増減は、値決め時と販売時の為替レートの差により生じる
- そのため、急速に円高が進行すると、為替レートの差が大きくなるため、仕入値引債権の評価額が大幅に減少
- これにより、売上原価が増加し、売上総利益が減少

例：仕入れ価格10ドルの製品を販売する際の売上原価の変化

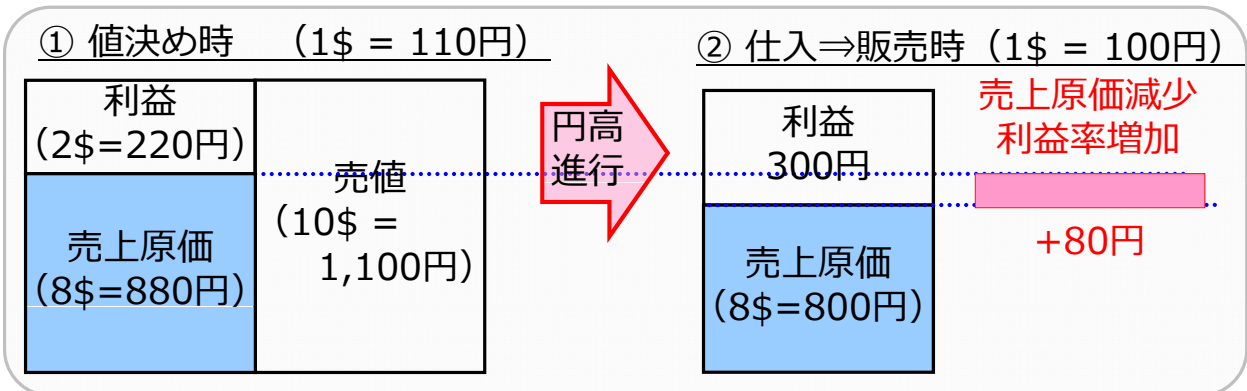


為替変動による影響の発生要因②

【調達在庫の為替変動による影響】

- 海外から仕入れたドル建の製品において、為替レートが円高に進行することにより、売上原価が減少し、売上総利益は増加

例：仕入れ価格10ドルの製品を販売する際の売上原価の変化



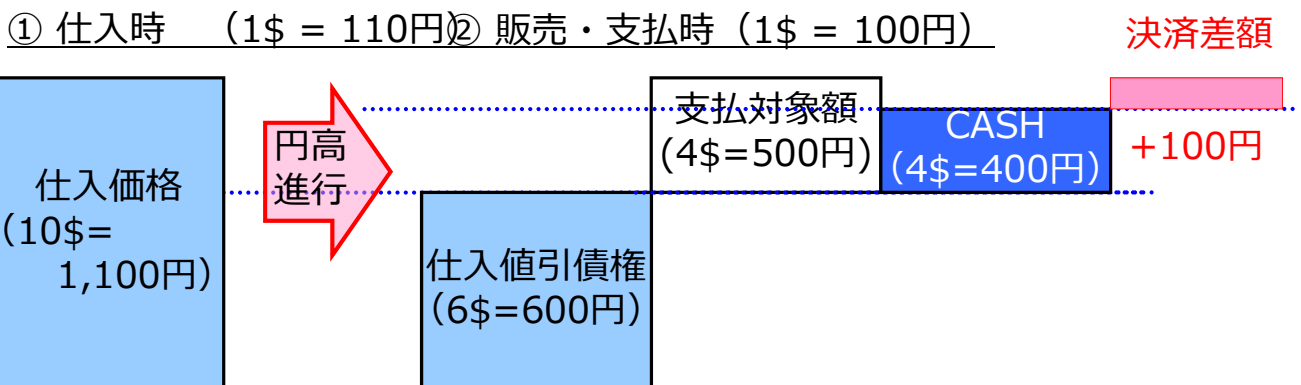
57

© 2018 PALTEK Corporation. All rights reserved.

為替変動による影響の発生要因③

【決済時のドル調達レート変動による影響】

- 支払を行う際に円高に進行していた場合、ドルを調達する金額が少なくなるため、決済差額が生まれ、為替差益を計上することとなる
- 一方、円安に進行した場合は、為替差損を計上することとなる



58

© 2018 PALTEK Corporation. All rights reserved.

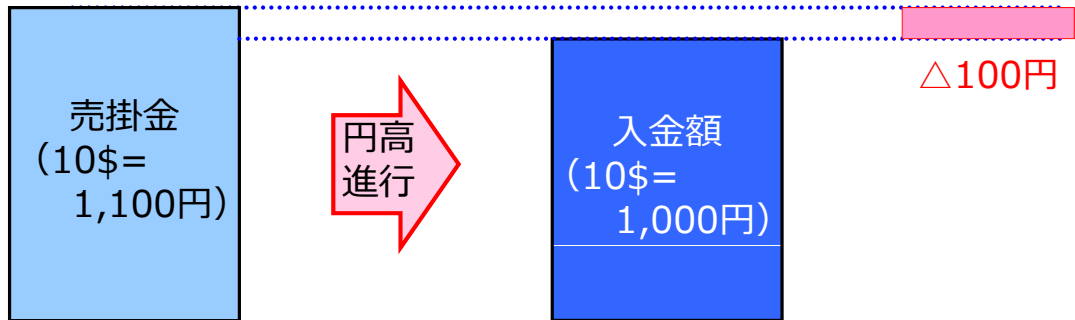
為替変動による影響の発生要因④

【ドル建売掛金入金時のレート変動による影響】

- ドル建売掛金のお入金がある場合には、円高に進行するとマイナス、円安に進行するとプラスの影響が発生する（営業外の為替差損益）
- 当社はこのリスクを限定的にするために、為替予約を行っている

① 販売時 (1\$ = 110円)

② 入金時 (1\$ = 100円) **決済差額**



開示区分について

開示区分	内容説明
半導体事業	半導体及び関連製品の販売、技術支援
FPGA	ザイリンクス社のFPGAを中心とするソリューション
特定用途IC	特定用途に特化した半導体を中心とするソリューション (例：通信向け、インタフェース向け、携帯端末向け等)
汎用IC	NXPセミコンダクターズ社、マイクロチップテクノロジー社等の汎用ICを中心とするソリューション
アナログ	アナログ半導体を中心とするソリューション
メモリ	マイクロンテクノロジー社等のメモリを中心とするソリューション
デザインサービス事業	受託開発、ODM/EMS/OEM
ソリューション事業	最終製品レベルでのソリューション提案を実施 自社製品（ハードウェア、ソフトウェア、システム）の開発・販売



以下の担当までお問い合わせ下さい。

株式会社PALTEK

柴崎 由記（総務グループ IR担当）

〒222-0033
横浜市港北区新横浜2-3-12 新横浜スクエアビル
TEL : 045-477-2072
FAX : 045-477-2012
E-mail : ir@paltek.co.jp